

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成24年4月26日(2012.4.26)

【公表番号】特表2011-516113(P2011-516113A)

【公表日】平成23年5月26日(2011.5.26)

【年通号数】公開・登録公報2011-021

【出願番号】特願2011-500846(P2011-500846)

【国際特許分類】

A 6 1 M 25/00 (2006.01)

A 6 1 F 2/84 (2006.01)

A 6 1 B 18/12 (2006.01)

A 6 1 B 17/00 (2006.01)

【F I】

A 6 1 M 25/00 3 1 4

A 6 1 M 29/00

A 6 1 B 17/39 3 1 0

A 6 1 B 17/00 3 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月2日(2012.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

切断用高周波カテーテル組立体であって、

ルーメンを画定する中央ライナと、

前記中央ライナに該中央ライナの遠位端部で結合された高周波電極であって、該高周波電極を通る前記中央ライナの前記ルーメンからの流路を提供するよう整列したルーメンを画定する高周波電極と、

前記中央ライナに結合された灌水溶液のパルス源と、

前記高周波電極の周りに設けられた外側絶縁体と、を有し、

該外側絶縁体の円周方向外側エッジ表面が、前記高周波カテーテル組立体の外側円周方向エッジ表面の一部分を構成する、

ことを特徴とする切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項2】

前記中央ライナと前記高周波電極との間に設けられた内側絶縁体を更に有し、

該内側絶縁体は、前記中央ライナの前記ルーメンから前記高周波電極により画定される前記ルーメンまでの流路を提供するよう整列したルーメンを画定する、

請求項1記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項3】

前記高周波電極は、凸状外側エッジ表面を更に有する、

請求項1記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項4】

前記高周波電極は、凹状外側エッジ表面を更に有する、

請求項1記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項5】

前記切断用高周波カテーテル組立体の前記外側エッジ表面は、前記凹状外側エッジ表面とリング状外側エッジ表面の組み合わせである、

請求項 4 記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項 6】

前記中央ライナの前記遠位端部が、前記内側絶縁体内に設けられている、

請求項 2 記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項 7】

前記内側絶縁体が耐熱電気絶縁体として機能する材料で作られている、

請求項 2 または請求項 6 記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項 8】

前記内側絶縁体は環状壁を有し、この環状壁は、その一端部の周りに外部リップを有すると共にその反対側の端部の周りに内部リップを有している、

請求項 2 、請求項 6 、請求項 7 のいずれか 1 項に記載の切断用高周波カテーテル組立体。

。

【請求項 9】

前記外部リップの外径及び長手方向軸線に沿う前記外部リップの長さは、前記中央ライナを前記高周波電極の環状区分から伝導された熱から隔離するよう選択される、

請求項 8 記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項 10】

前記長手方向軸線に沿う前記内部リップの長さは、前記中央ライナを前記高周波電極から伝導された熱から隔離するよう選択される、

請求項 8 または請求項 9 記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【請求項 11】

前記外側絶縁体は耐熱電気絶縁体である、

請求項 3 、請求項 6 乃至請求項 10 のいずれか 1 項に記載の切断用高周波カテーテル組立体。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 2

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【0 0 4 2】

1 本又は複数本の熱可塑性チューブを中央ライナ及び R F 導体に被せて熱収縮させ、それにより R F 電極 6 4 1 からハンドル 6 1 6 まで延びるカテーテルシャフト 6 4 2 を形成する。中央ライナが熱可塑性チューブで覆われているカテーテルシャフト 6 4 2 を形成する技術は、先行技術において用いられている技術と同じであり、従って、この説明を考慮する当業者には知られている。例えば、カテーテルシャフトを通る電力及び流れチャネルを提供する技術は、1999年6月29日にハイサグエレ等 (Haissaguerre et al) の米国特許第 5 , 9 1 6 , 2 1 3 号明細書 (発明の名称 : Systems and Methods for Tissue Mapping and Ablation) に記載されている。